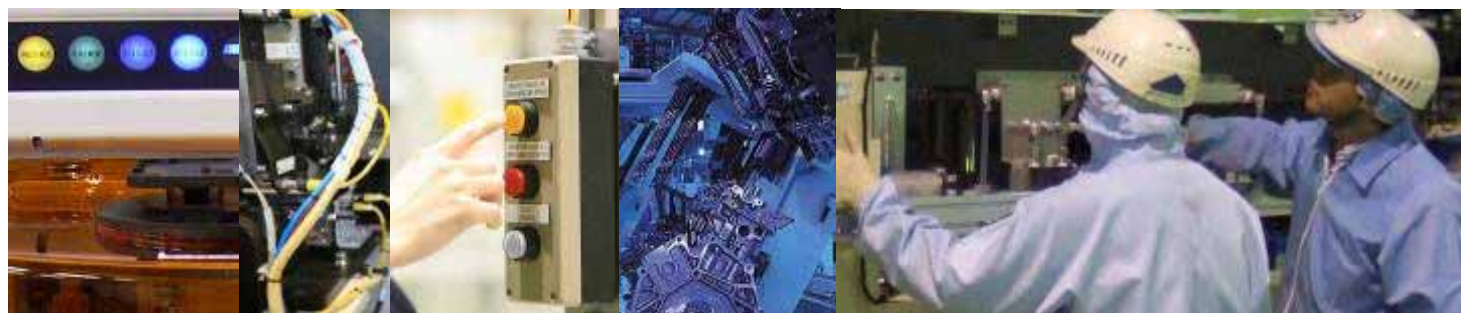
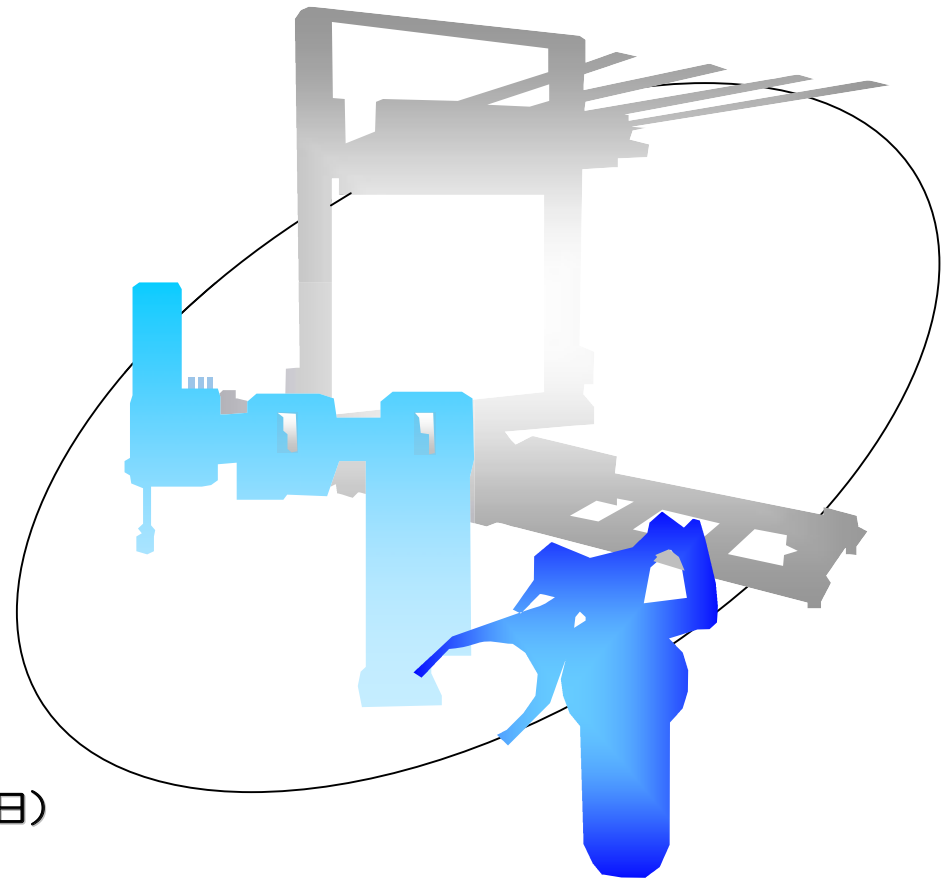

2008年3月期 第3四半期決算説明資料

平田機工株式会社 2008.2.18

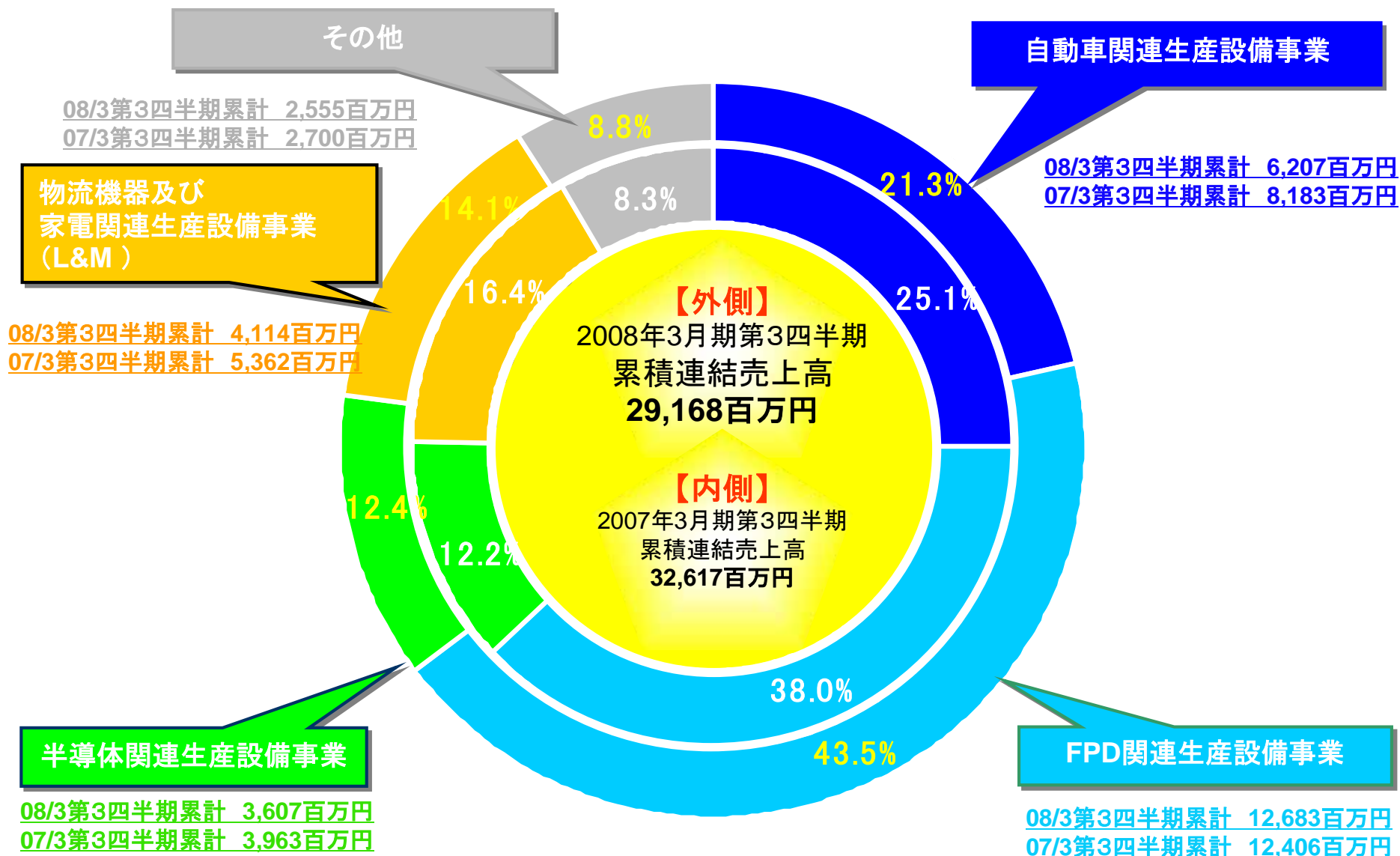


I 第3四半期決算状況

2008年3月期 第3四半期 (2007年12月31日)



I 第3四半期決算状況 事業部門別累積売上高構成比

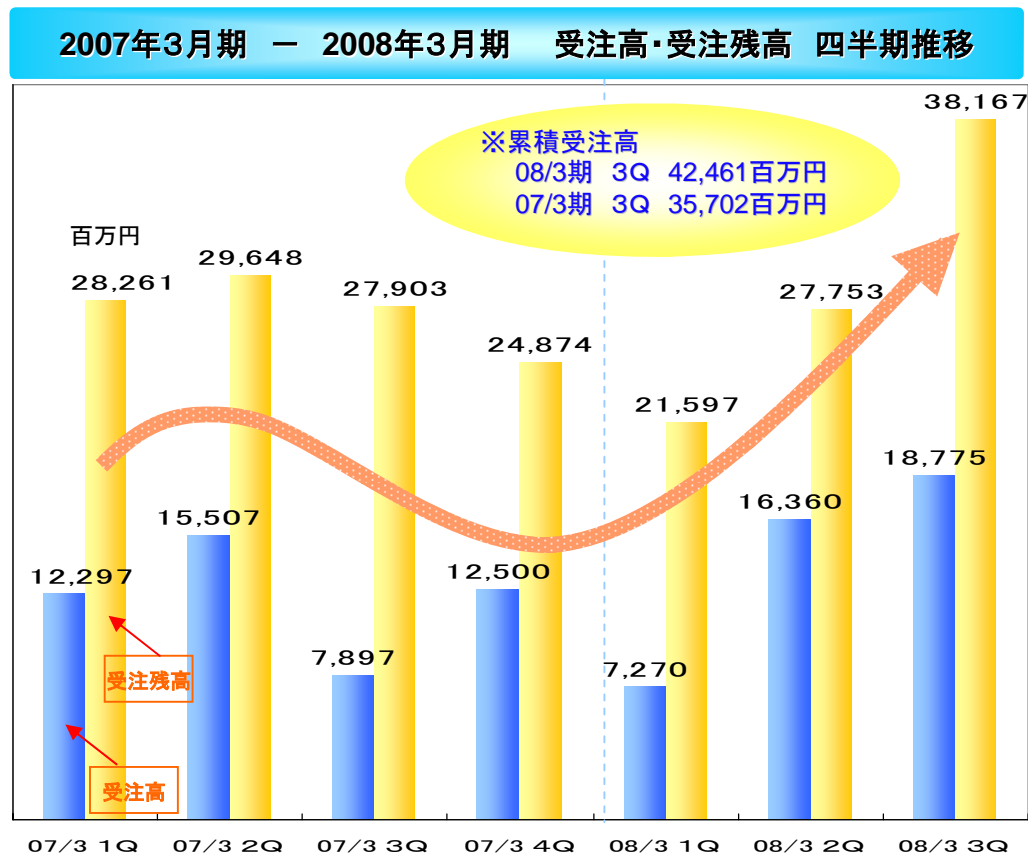
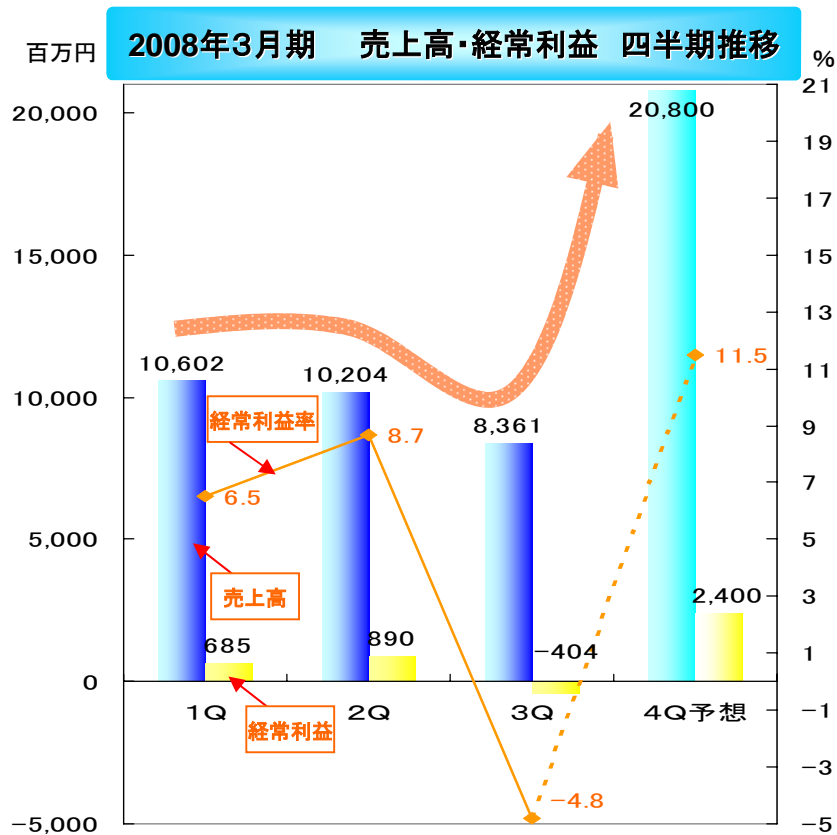


I 第3四半期決算状況

2008年3月期第3四半期の実績

- ◆ 売上高および利益率は一時的に落ち込むものの、第4四半期は大幅な売上増加となり、通期では期首計画達成を見込む。また、受注は堅調に増加しており、今期の受注高は過去最高となる見込み。

当四半期は売上の谷間となり、売上高、経常利益共に低下した。しかし、受注高は第3四半期単期で18,775百万円と増加(対前年同期比137.8%増、対第2四半期比14.8%)を続け、受注残は38,167百万円と大幅な増加(前年同期比36.8%増、対第2四半期比37.5%)となった。第4四半期は売上高が大幅に増加する見込みであり、通期では期首計画50,000百万円を見込む。



I 第3四半期決算状況

事業部門別実績 連結売上高

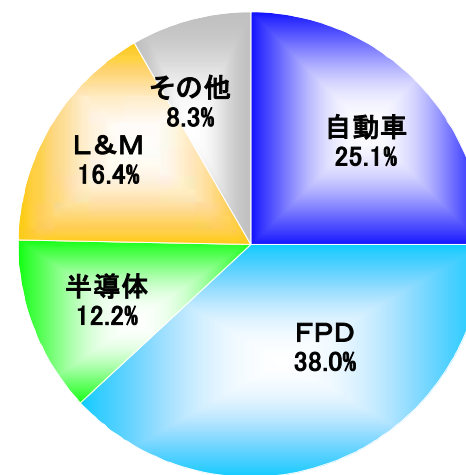
- 自動車関連設備は、国内向け・北米向け共に売上の谷間となり、減収(▲24.1%)
- FPD関連設備は、国内向けを中心に好調持続し増収(+2.2%)
- 半導体関連設備は、DRAM価格下落等に伴うデバイスメーカーの設備投資抑制の影響により減収(▲9.0%)
- L&M関連設備は、タイヤ・家電共に受注は堅調に推移したが、売上の谷間となり減収(▲23.3%)

事業部門別累積売上高の状況

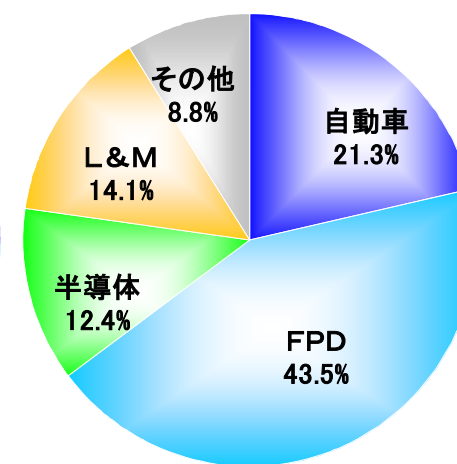
単位:百万円

事業部門	2007/3 第3四半期	2008/3 第3四半期	前年同期比
自動車	8,183	6,207	▲ 24.1%
FPD	12,406	12,683	2.2%
半導体	3,963	3,607	▲ 9.0%
L&M	5,362	4,114	▲ 23.3%
その他	2,700	2,555	▲ 5.4%
合計	32,617	29,168	▲ 10.6%

2007/3 第3四半期(累積)



2008/3 第3四半期(累積)



I 第3四半期決算状況 事業部門別実績 地域別連結売上高

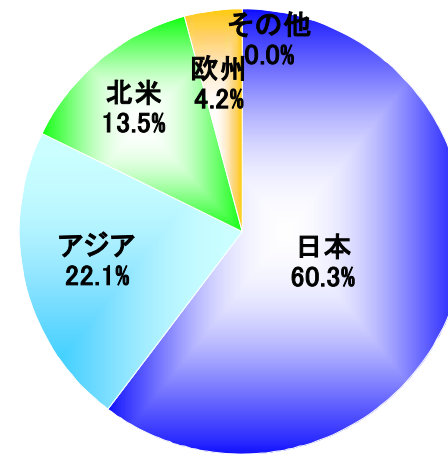
- ・ 日本国内向けは、FPD関連設備などが堅調で増加(+3.8%)
- ・ アジア向けは、FPD関連設備で復調の兆しはあるものの前年同期の水準には至らず減少(▲76.4%)
- ・ 北米は、自動車関連設備は低調であったものの、家電関連・タイヤ関連の売上もあり増加(+13.0%)
- ・ 欧州は主としてテレビなど家電関連設備の売上増加により増加(+53.7%)

地域別累積売上高の状況

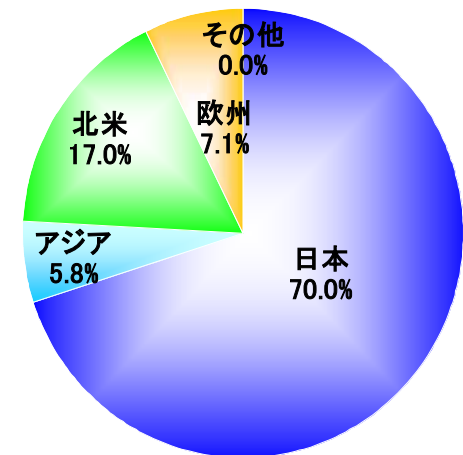
単位:百万円

地域	2007/3 第3四半期	2008/3 第3四半期	前年同期比
日本	19,668	20,414	3.8%
アジア	7,194	1,700	▲76.4%
北米	4,397	4,969	13.0%
欧州	1,355	2,084	53.7%
その他	1	0	▲100.0%
合計	32,617	29,168	▲10.6%

2007/3 第3四半期(累積)



2008/3 第3四半期(累積)



I 第3四半期決算状況 事業部門別実績 連結受注高

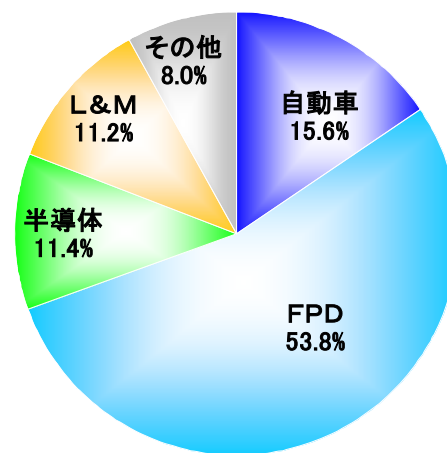
- 自動車関連生産設備は、カミズ社の大口案件受注などにより増加(+137.2%)
- FPD関連生産設備は、大口案件の受注により上期の減少をカバーするも前年同期に及ばず減少(▲ 21.0%)
- 半導体関連生産設備は、デバイスメーカーの設備投資抑制の影響により減少(▲10.6%)
- L&M関連生産設備は、タイヤ・家電共に堅調に推移し増加(90.8%)

事業部門別累積受注高の状況

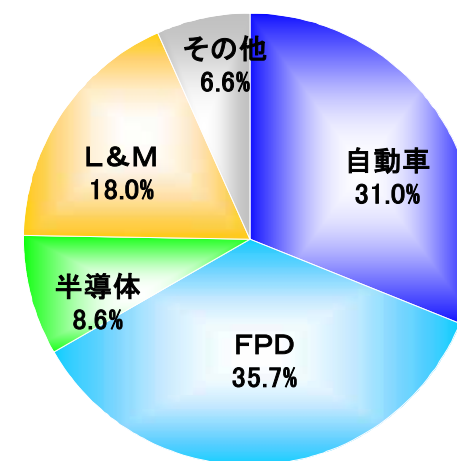
単位:百万円

事業部門	2007/3 第3四半期	2008/3 第3四半期	前年同期比
自動車	5,552	13,169	137.2%
FPD	19,202	15,174	▲ 21.0%
半導体	4,083	3,652	▲ 10.6%
L&M	4,015	7,660	90.8%
その他	2,848	2,804	▲ 1.6%
合計	35,702	42,461	18.9%

2007/3 第3四半期(累積)



2008/3 第3四半期(累積)



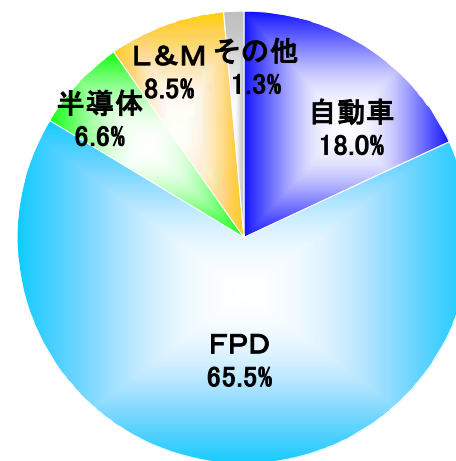
I 第3四半期決算状況 事業部門別実績 連結受注残高

- 自動車関連生産設備は、クライスラー社、カミンズ社の大口案件を中心に積み増し、増加(+165.7%)
- FPD関連生産設備は、堅調に推移するも前年同期の水準に及ばず減少(▲9.0%)
- 半導体関連生産設備は、デバイスメーカーの設備投資抑制の影響により減少(▲13.2%)
- L&M関連生産設備は、タイヤ・家電共に堅調に推移し増加(+150.4%)

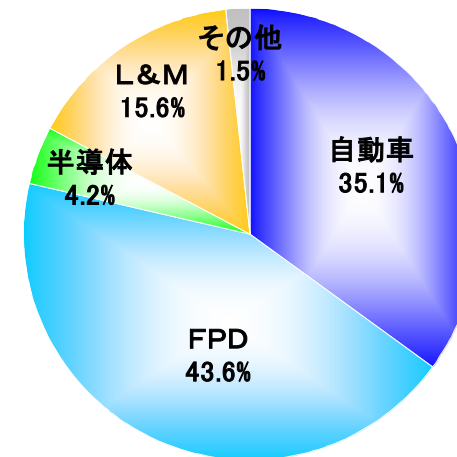
事業部門別受注残高の状況 単位: 百万円

事業部門	2007/3 第3四半期	2008/3 第3四半期	前年同期比
自動車	5,035	13,381	165.7%
FPD	18,269	16,625	▲ 9.0%
半導体	1,854	1,610	▲ 13.2%
L&M	2,381	5,963	150.4%
その他	362	587	62.1%
合計	27,903	38,167	36.8%

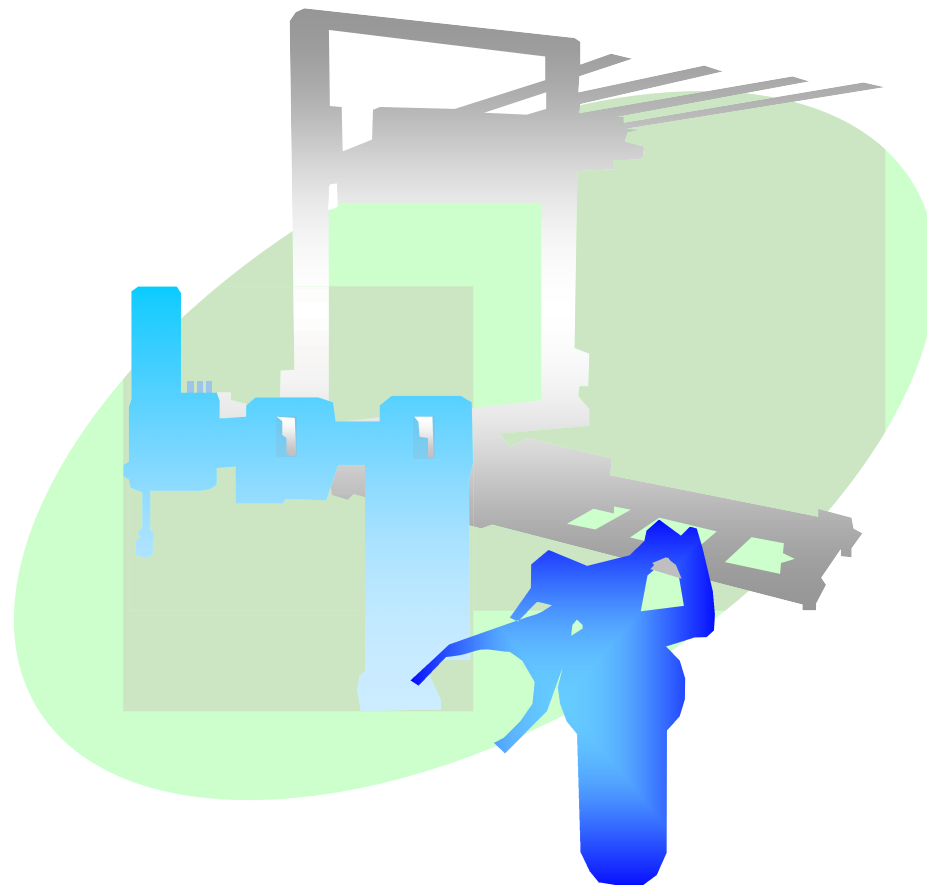
2007/3 第3四半期



2008/3 第3四半期



II 今期業績の見通し



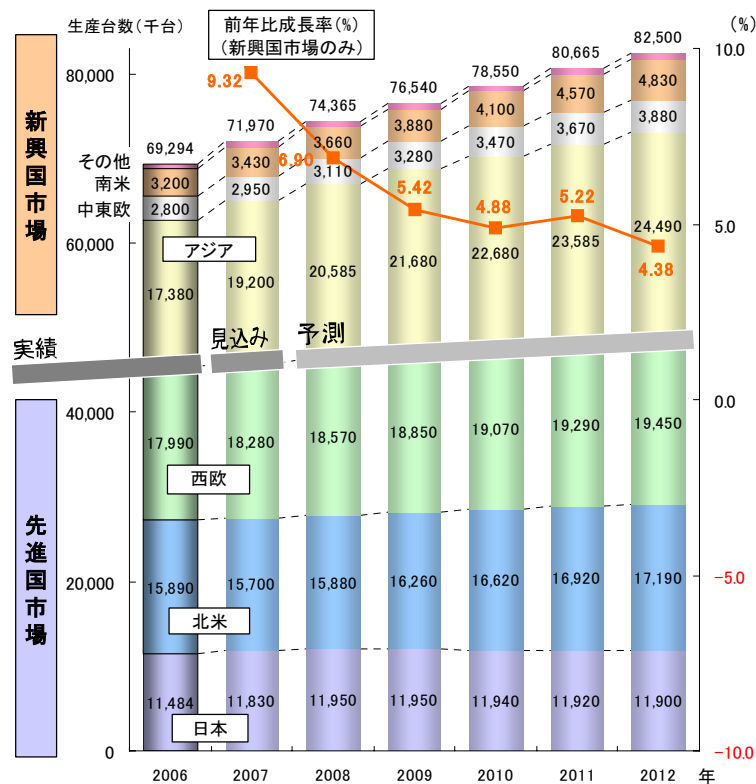
II 今期末・来期の見通し

事業環境

◆自動車関連事業

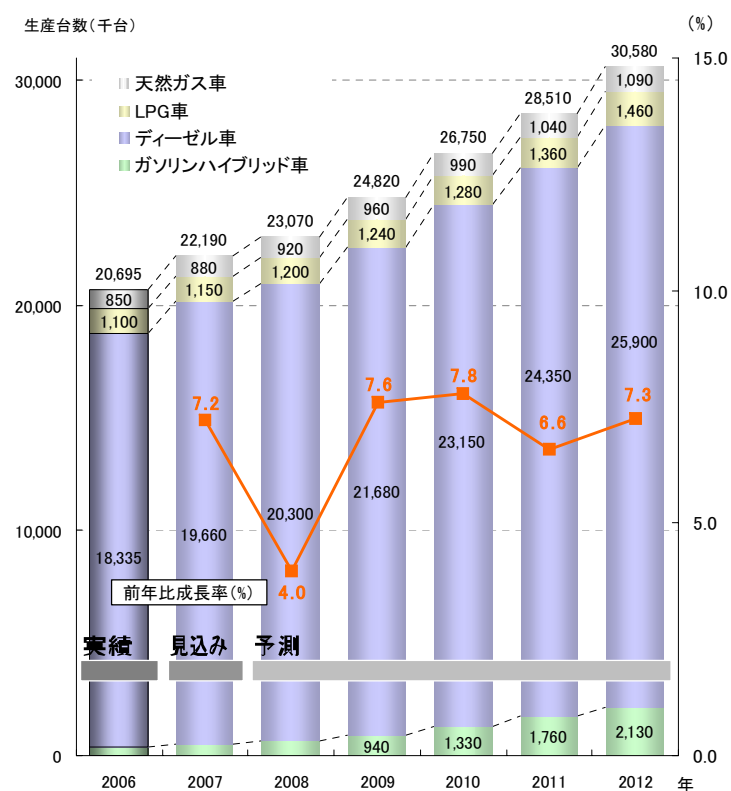
- 西欧・北米及び日本国内の市場成長が低迷しているなか、中国を中心とする新興国市場で5%程度の成長が堅調に推移する。
- 地球環境に配慮したディーゼル、ハイブリッド等の次世代の自動車への移行が更に進む。

地域別生産台数予測 [千台]



出所: 富士キメラ総研

次世代自動車生産台数予測 [千台]

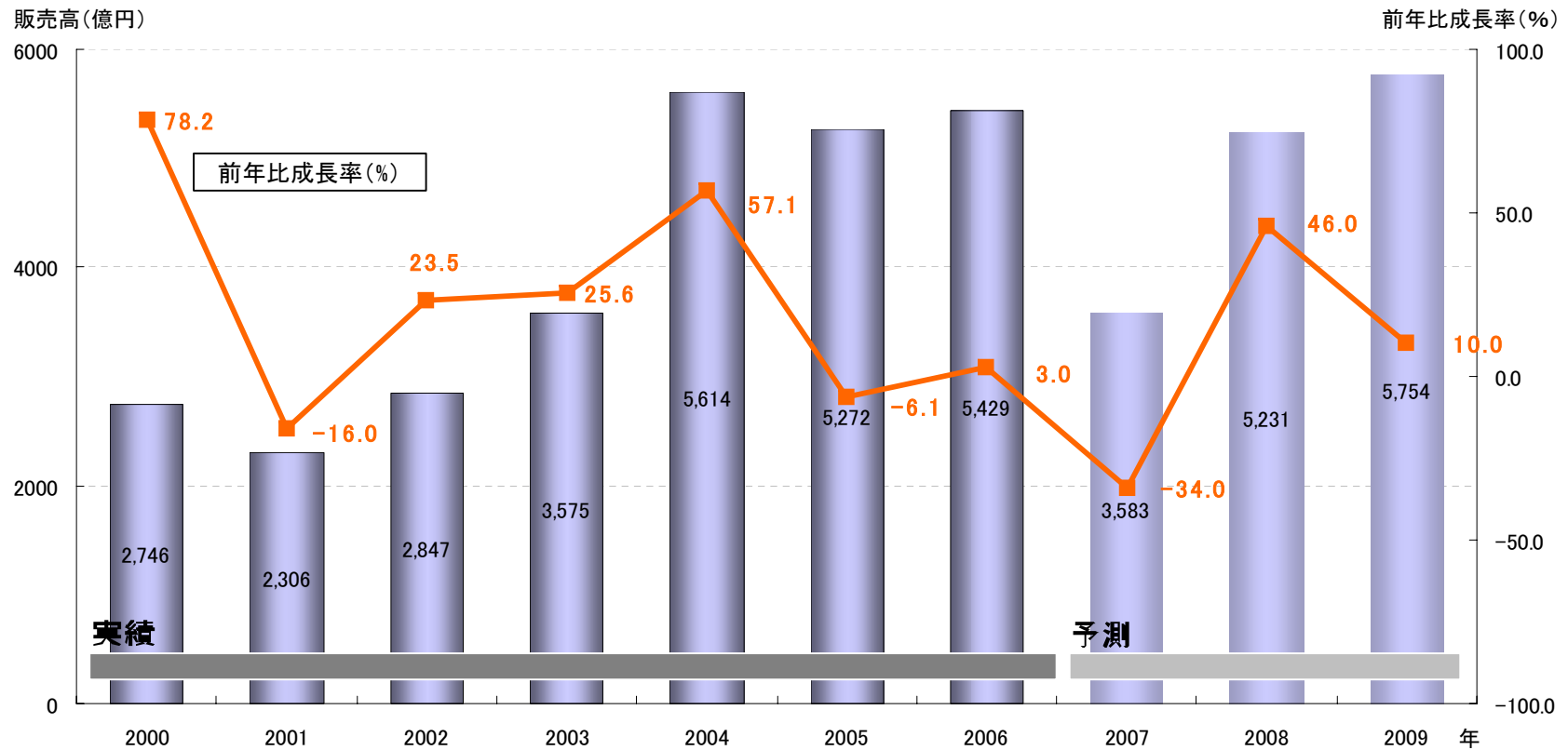


出所: 富士キメラ総研

◆ FPD関連事業

- 2006年度後半からFPDパネルが供給過剰になったことにより2006年度後半から2007年度にかけて各メーカーの投資計画が見直され製造装置市場の成長が低迷したが、2008年以降はこれに反動しプラス成長に転じると予測される。
- 国内各メーカーの大型投資や、台湾・韓国・中国のパネル大手の生産設備の増設が始まっている。

日本製FPD製造装置の販売高予測 [億円]

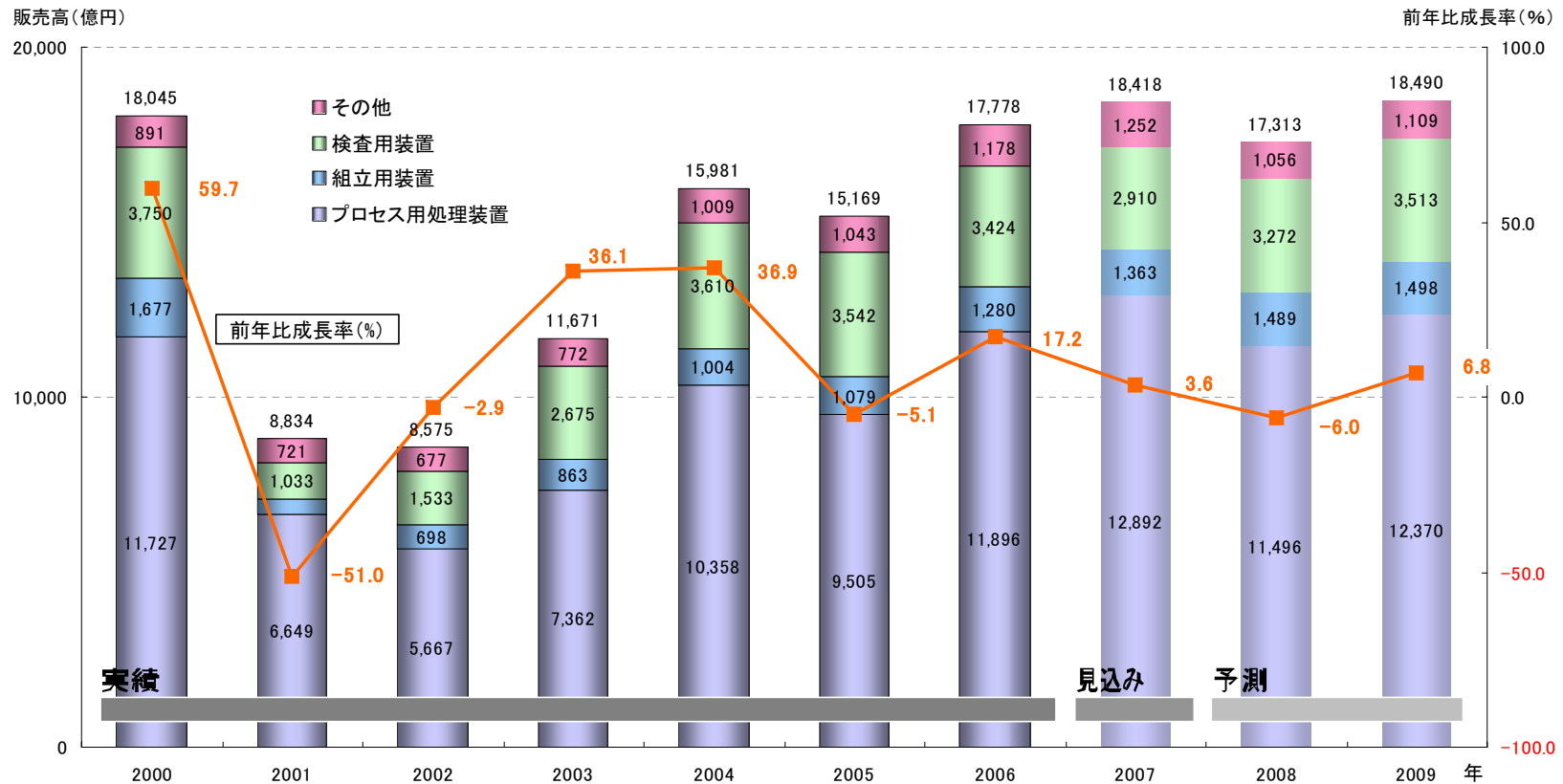


出所: 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)

◆半導体関連事業

- 2008年度の半導体市場は、2006年の市場を牽引したDRAMが価格の下落から大幅に減速する一方、フラッシュが大幅に伸長する傾向にある。
- 半導体製造装置について、2008年度は、2007年前半の旺盛なメモリ投資の煽りを受ける形でマイナス成長に転じるものの、2009年度は再びプラス成長に転じると予測される。

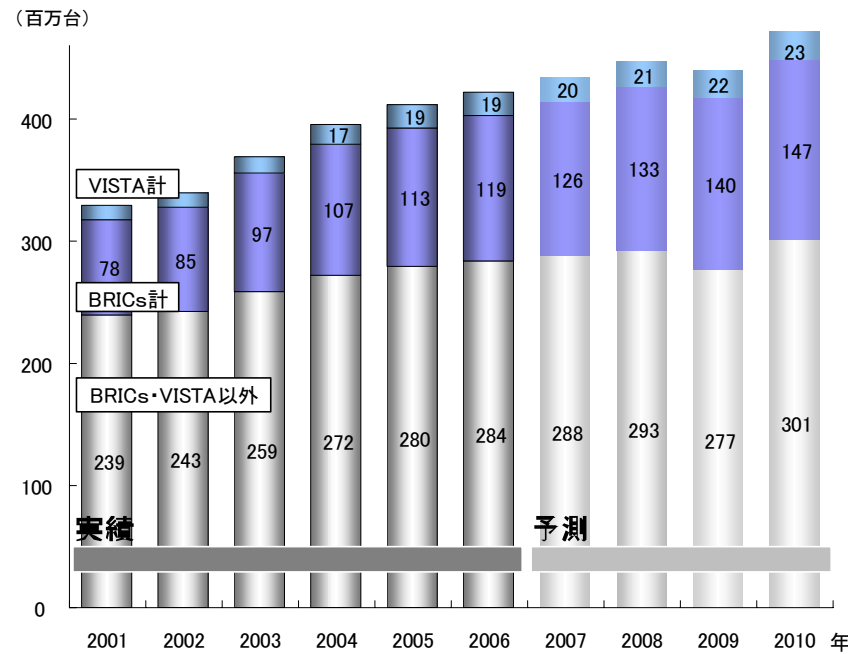
日本製半導体製造装置の販売高予測 [億円]



◆ L&M関連事業

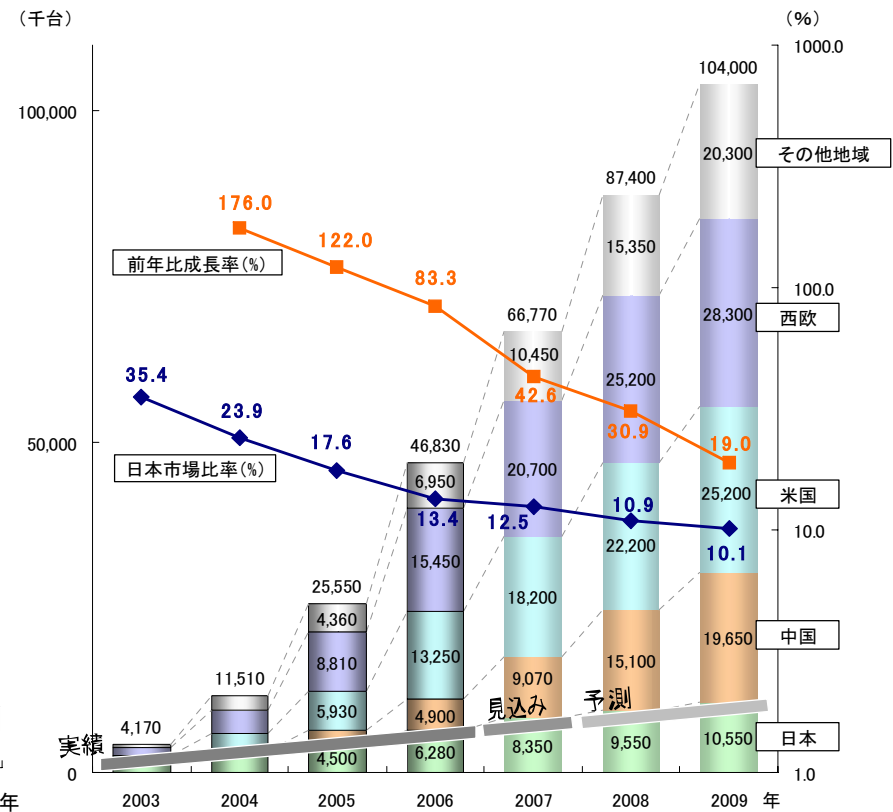
- 白モノ家電市場においては、先進国はほぼ横ばいに推移すると見込まれる一方、BRICsをはじめとする新興市場の需要拡大に牽引され、堅調に推移することが予想される。
- FPDテレビ市場についても、BRICs等新興市場での普及が本格化し、世界中へ急速に広がることが予想される。

地域別白物家電(7品目) 世界需要予測 [千台]



出所: 日本電機工業会 (JEMA)

FPDテレビ世界需要予測 [千台]



出所: 電子情報技術産業協会 (JEITA) の資料を基に作成

Ⅱ 今期業績の見通し 連結業績予想

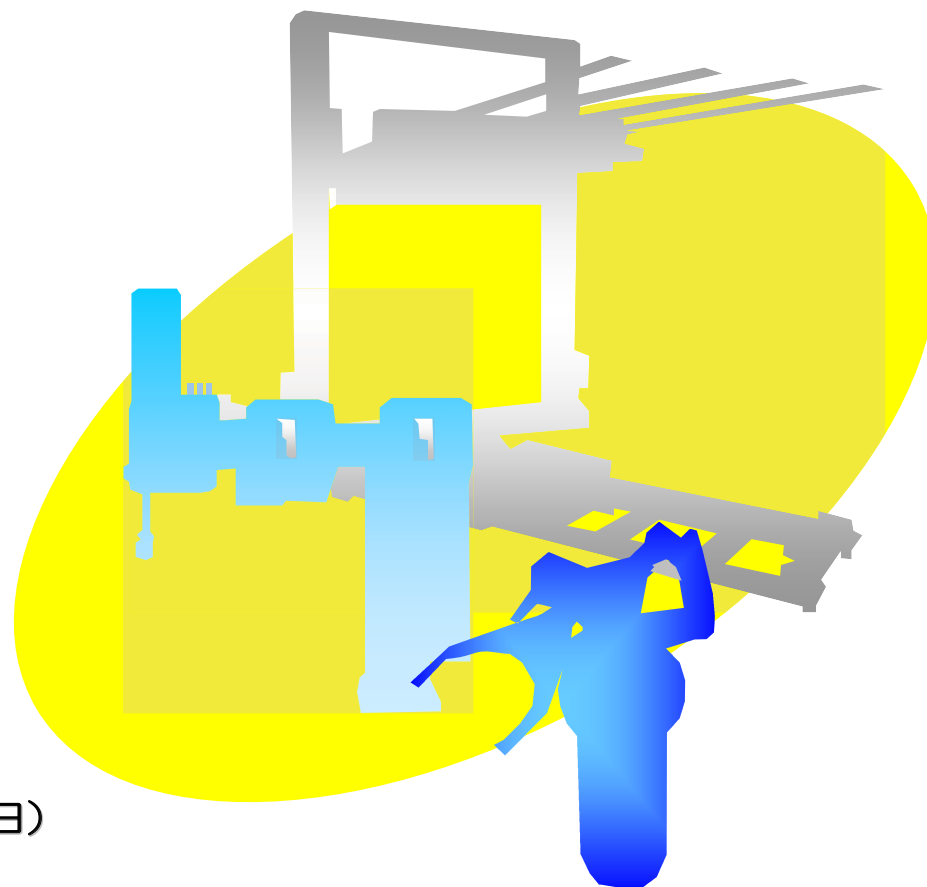
- ◆ 売上高は、自動車関連が微減、FPD関連、半導体関連はほぼ前期並み、L & M関連は増収し、全体では増収を見込む
- ◆ 営業利益は、内製率の更なる拡大に加え、品質向上活動による後掛費用の削減等により、増益確保を目指す

(単位:億円、%)

	2007年3月期	2008年3月期			
		上期(実績)	下期(見通し)	通期(見通し)	対前期増減
売上高	481	208	291	500	+3.8%
自動車関連	130	43	80	124	▲5.0%
FPD関連	183	97	85	183	▲0.1%
半導体関連	57	22	34	57	▲0.7%
L & M関連	76	27	67	95	+24.9%
その他	34	17	23	41	+19.6%
営業利益(率)	37(7.7%)	16(8.0%)	21(7.3%)	38(6.2%)	+2.5%
経常利益(率)	34(7.1%)	15(7.6%)	20(6.9%)	36(5.5%)	+5.2%
当期純利益(率)	18(3.9%)	6(3.1%)	13(4.6%)	20(4.0%)	+7.0%

Ⅲ 中期経営計画

2008年3月期 第3四半期（2007年12月31日）



Ⅲ 中期経営計画

自動車・FPD・半導体分野における生産エンジニアリングの
リーディングカンパニーへ

2007年 - 2009年
中期経営計画

持続的な成長を可能にする基礎づくり

中長期発展の基礎確立の為、組織的な経営体制の整備・強化

生産エンジニアリングとモノ造りを両輪としたグローバル企業

持続可能な競争力と安定的な業容・収益

■ 1・2・3・4計画の現状と見通し(単体ベース)

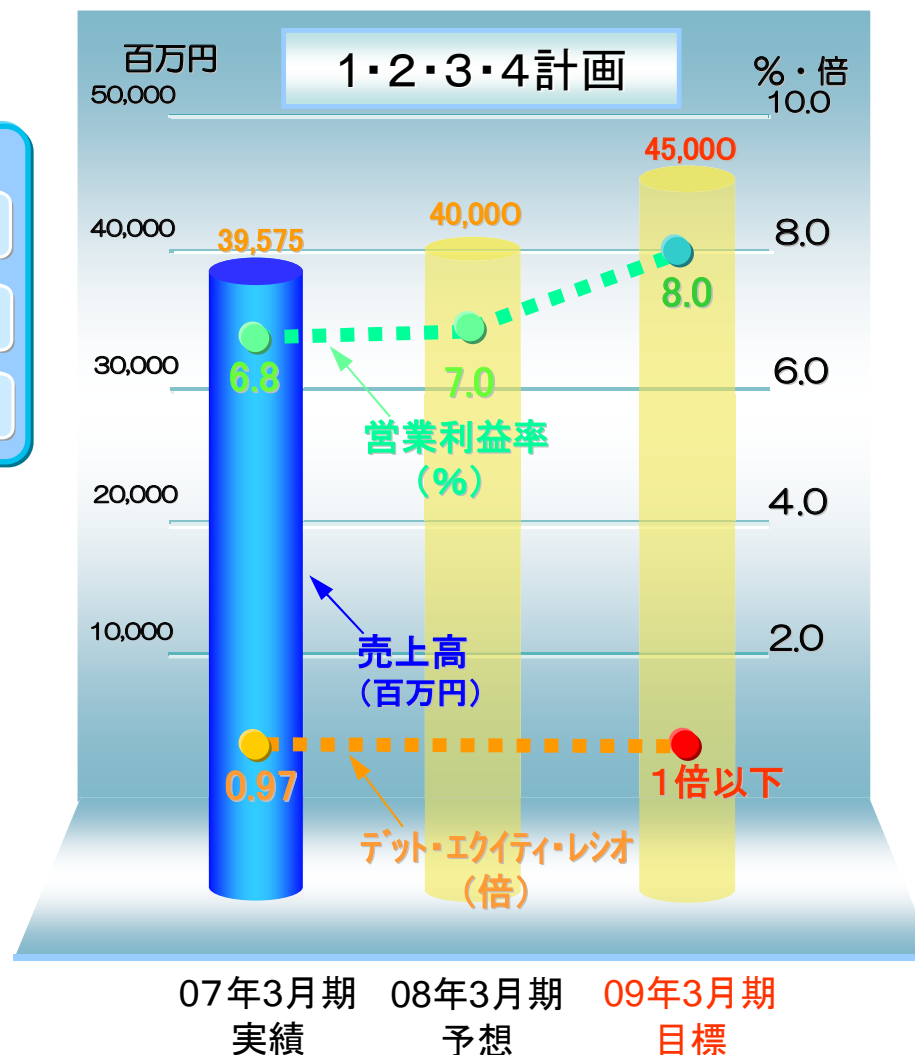
● 09年3月期に当社単体で以下の目標を達成する。

1: 有利子負債比率(デット・エクイティ・レシオ) **1**以下
当中間期実績は1.0倍。堅調に推移している。

2: 営業利益率 **2**倍(対05年3月期4.0%比)
当中間期実績は9.7%。堅調に推移している。

3: リードタイム **30**%以上削減
LT30プロジェクトによる削減活動を展開中。

4: 売上高 **450**億円
当期計画を達成すると共に更なる受注拡大を図る。



当社主力事業の施策・成果

FPD・半導体関連事業の競争力強化

●第10世代液晶パネル用ガラス基板搬送ロボットの開発

世界最大級(1辺3,000mm以上)大型ガラス基板の高速搬送を可能とするロボットを開発。

●BLUESHIFT社との業務提携

米国BlueShift Technologies, Inc.とEFEM(Equipment Front End Module)および真空搬送システムの販売・製造・サービスの各業務について提携。

受注増加に対応した生産能力の拡充

●新工場の取得・建設

受注増加による生産スペースの不足に対応すべく、熊本県菊池市に工場(七城工場)を取得すると共に、関西工場内にも新工場の建設を開始。

■七城工場(既存物件取得・改装) 2008年3月稼働予定

- ・所在地 : 熊本県菊池市七城町蘇崎1471-10および11
- ・敷地面積22,493㎡ ・延床面積12,511㎡

■関西新工場(新設) 2008年6月稼働予定

- ・所在地 : 滋賀県野洲市小堤500番地(関西工場敷地内)
- ・延床面積 2,667㎡ (関西工場敷地面積 30,048㎡)

自動車関連事業 大手顧客によるACS採用

●クライスラー社・カミンズ社からエンジン組立ラインの大口受注

当社独自の生産システムACSコンセプトが大手顧客に評価され、大口受注が相次ぐ。
米国クライスラー社より新型エンジン組立ライン2ライン(受注総額70億円)を受注。
米国カミンズ社より、ディーゼルエンジン組立ライン(受注総額20億円)を受注。



国内・海外子会社の基盤強化・整備

海外戦略拠点の整備・強化

●台湾現地法人HCTの本格稼働・中国現地法人HASの工場建設開始

台湾現地法人HCTが本格的に稼働開始。中国現地法人HASの工場は2008年5月完成予定。



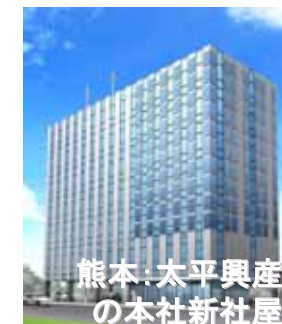
国内子会社の基盤強化

●保守サービス事業子会社ヒラタFEの稼働

当社生産設備納入後の保守・メンテナンス事業強化のため、業務を開始。

●IJ社との資本提携によるソフトウェア事業子会社TCCの経営基盤強化

IJ社のシステム構築、ネットワーク運用技術力を活用して、TCC(タイハイコンピュータ)のポイント管理事業発展を目指すべく資本提携実施。TCC本社を熊本から東京に移転。提携締結日:2007年4月16日



●制御部品販売事業等の子会社太平興産の本社新社屋建設・商号変更

太平興産の本社機能の充実と、主たる事業である機電販売センターの事業拡大を目的としたインフラ基盤整備のため、本社新社屋建設を開始。完成予定:2008年3月

また、事業内容を的確に表す商号に変更して企業イメージを刷新するため、商号をタイハイテクノス株式会社に変更することを決議。・変更日:2008年4月1日

財務基盤の強化・リスクヘッジ

為替リスクヘッジ・資本効率向上

●インパクト・ローンによる外貨借入れ

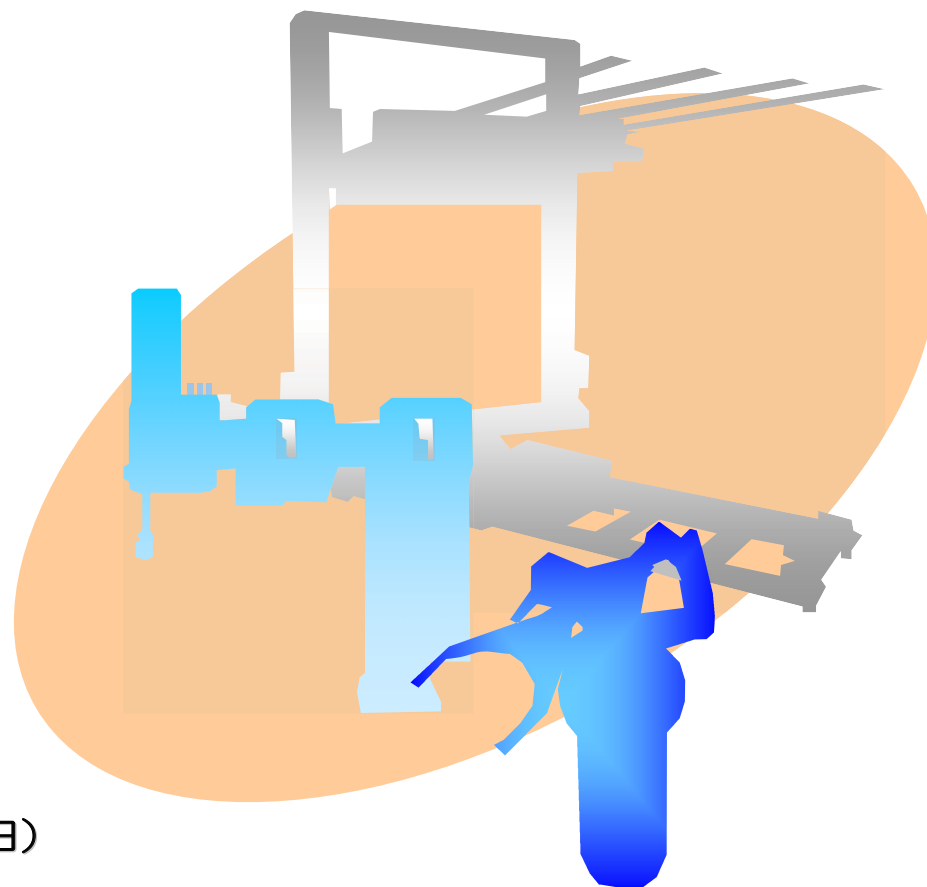
これまで為替予約を主たる為替リスクヘッジの手段として実施していたが、大口の外貨建て案件の受注や為替レートが円高基調に推移していることを勘案の上、インパクト・ローンによる外貨借入れを実施。

●自己株式の取得

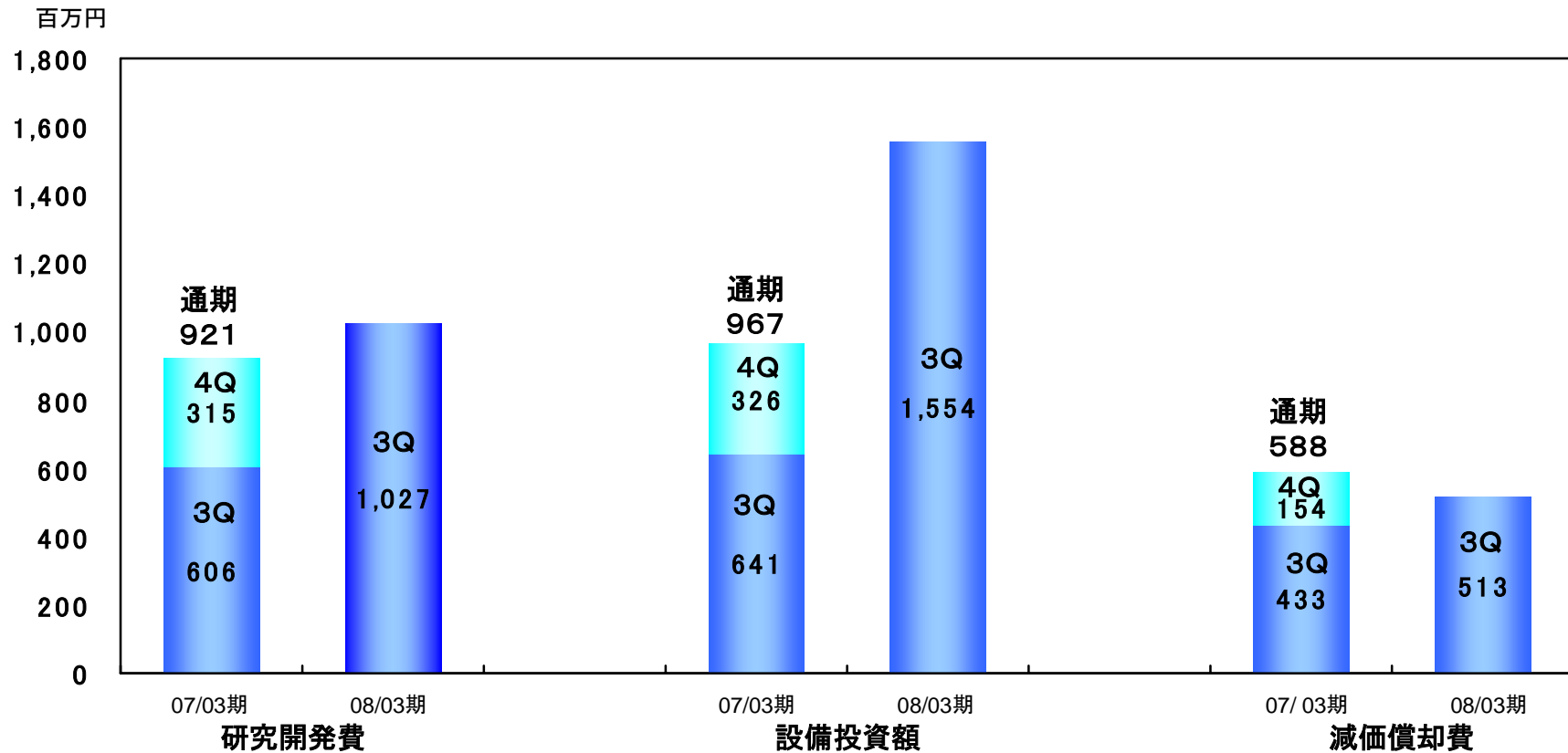
資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行するため、2007年9月13日から12月28日の期間に、当社普通株式を取得。取得株式数は112,900株であり、当社が保有する自己株式の総数は113,637株となる。・参考:発行済株式総数 10,756,090株

IV 参考資料

2008年3月期 第3四半期 (2007年12月31日)



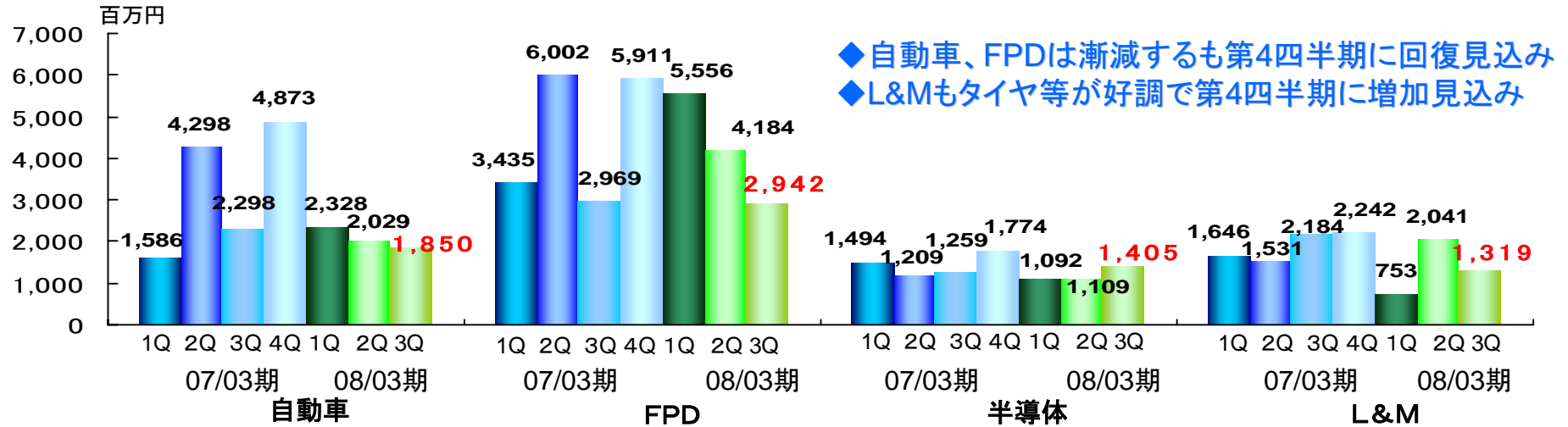
IV 参考資料 研究開発費・設備投資額・減価償却費



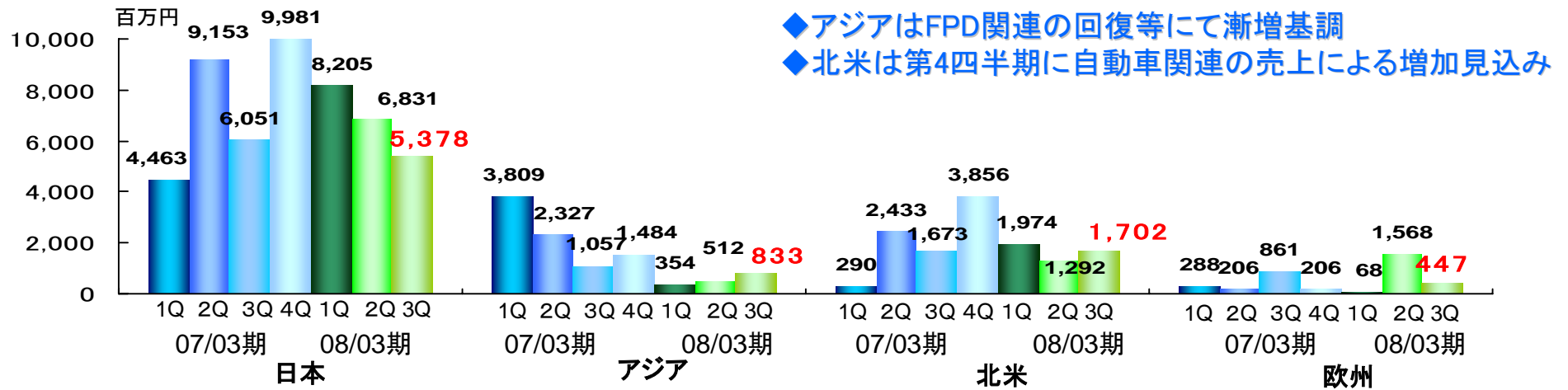
- 研究開発費： 主として、FPD関連、半導体関連設備の開発・試作により、対前年同期比69.5%増の1,027百万円を計上。
- 設備投資額： 平田機工自動化設備(上海)有限公司の本社及び工場建設費用、平田機工本体における加工機械購入等により、1,554百万円を計上。
- 減価償却費： 前年同期比18.4%増の 513百万円を計上。

IV 参考資料 事業部門別・地域別四半期推移(売上高)

事業部門別四半期売上高の推移

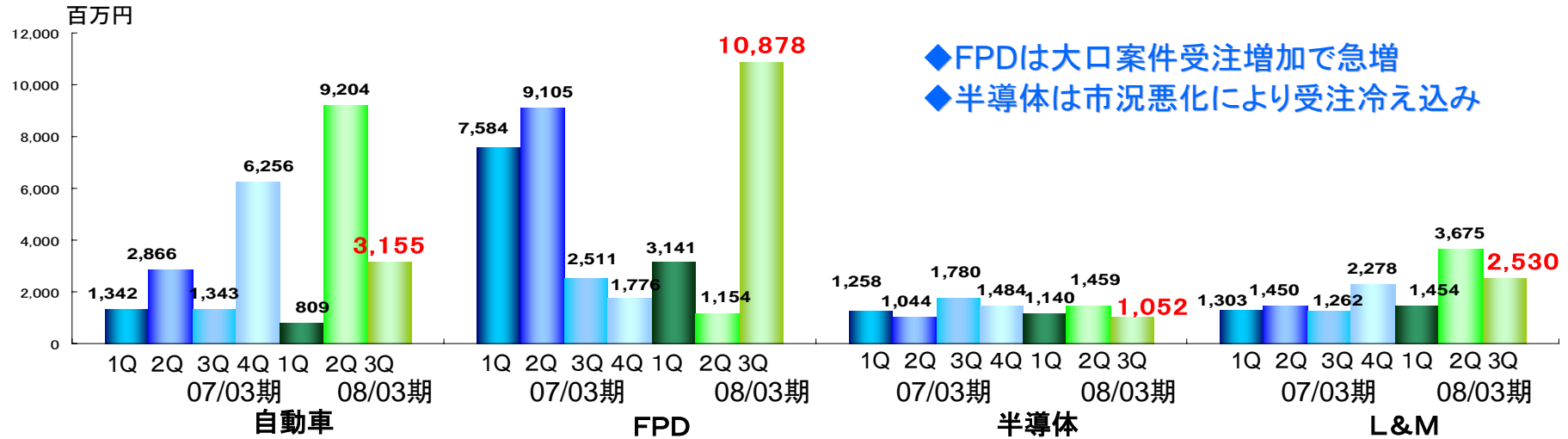


地域別四半期売上高の推移

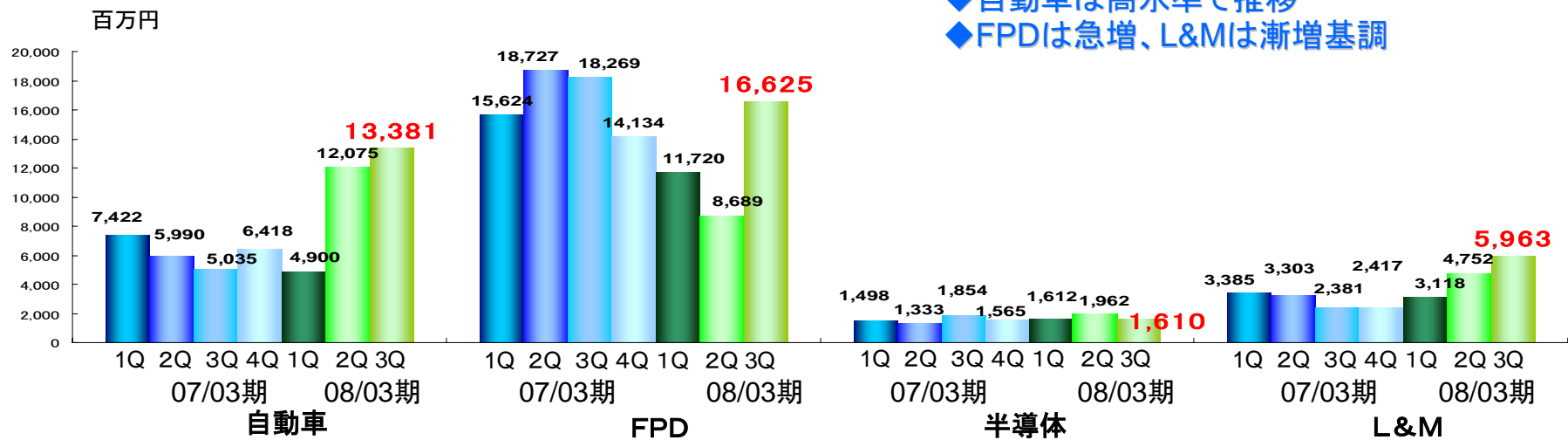


IV 参考資料 事業部門別四半期推移(受注高・受注残高)

事業部門別四半期受注高の推移

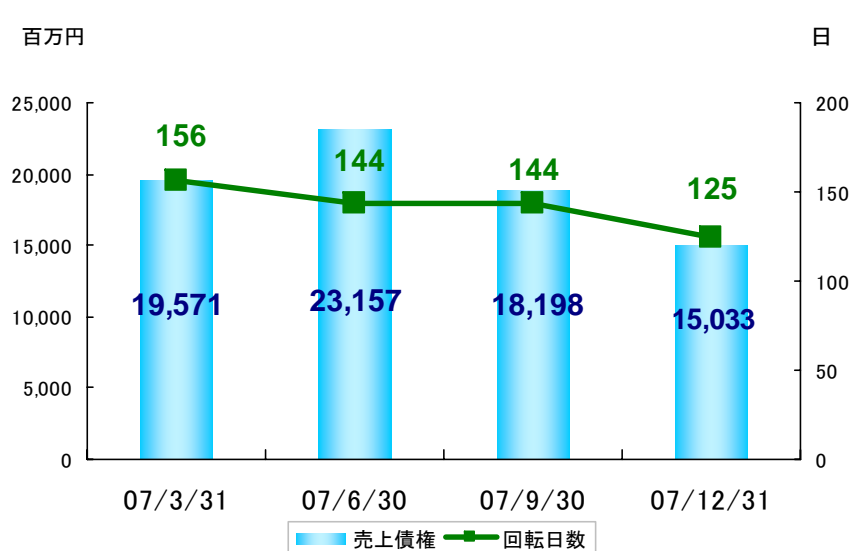


事業部門別四半期受注残高の推移

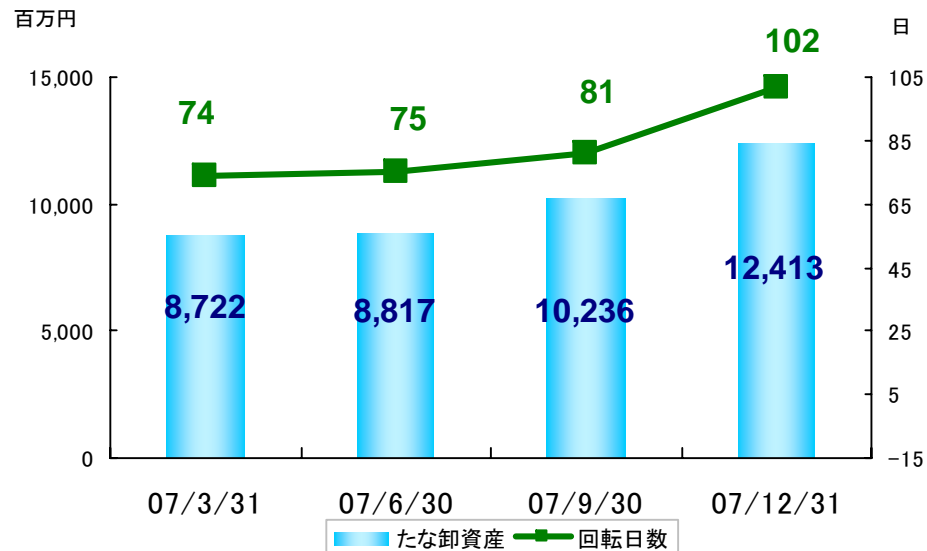


IV 参考資料 主要指標

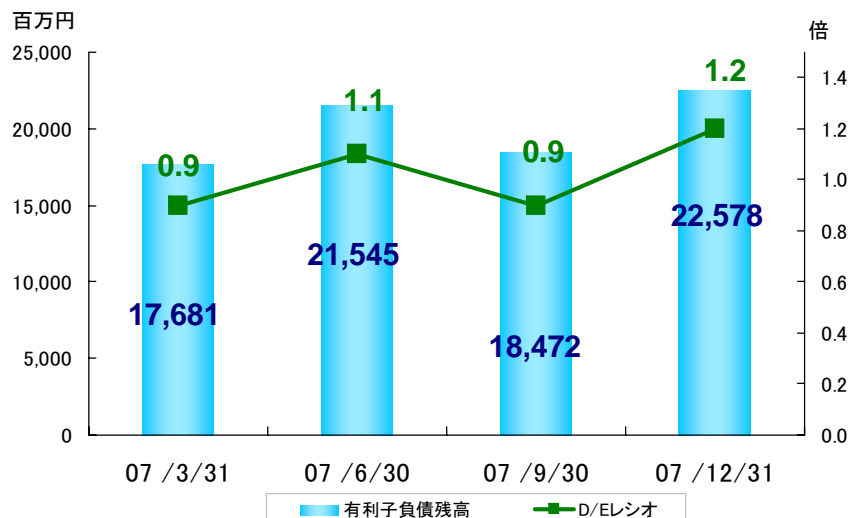
売上債権・売上債権回転日数



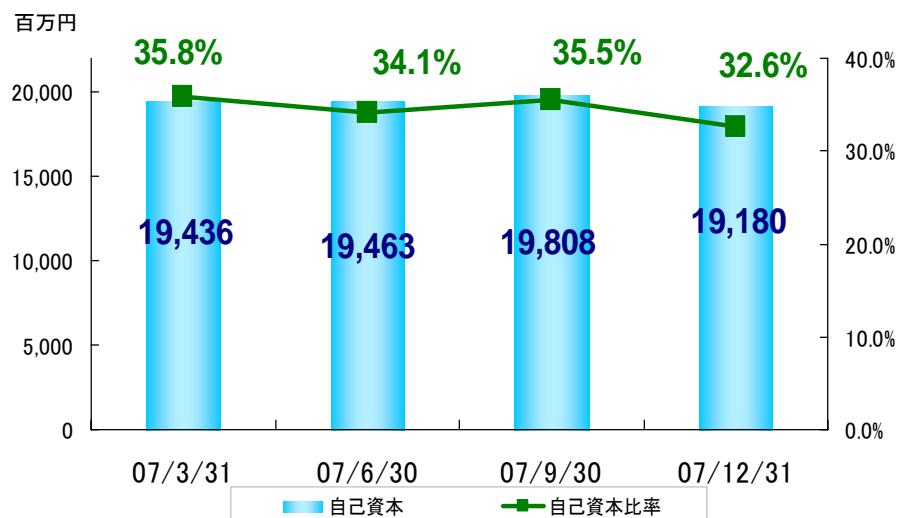
たな卸資産・たな卸資産回転日数



有利子負債残高・D/Eレシオ



自己資本・自己資本比率



本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることあることをご承知おきください。